

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2026-045

太龙电子股份有限公司

关于全资子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司（以下简称“全芯科微”）的经营需要，促进业务的开展，全芯科微拟向国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“国泰世华银行深圳分行”）申请综合授信额度不超过 2,200 万元，由公司全资子公司博思达科技（香港）有限公司（以下简称“博思达”）为上述授信额度提供存款质押担保，并于近日与国泰世华银行深圳分行签订了《押记契据（三方立约押记契据）》。

为了满足公司全资子公司芯星电子（香港）有限公司（以下简称“芯星电子”）和控股子公司香港仁天半导体科技有限公司（以下简称“香港仁天半导体”）的经营需要，芯星电子与香港仁天半导体分别向国泰世华银行有限公司香港分行（以下简称“国泰世华银行香港分行”）和中国信托商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“中国信托银行”）申请综合授信额度，博思达近日就上述担保签署了相关合同。子公司向国泰世华银行香港分行申请综合授信额度中，芯星电子的综合授信额度不超过 1,000 万美元，由博思达全额担保；香港仁天半导体的综合授信额度不超过 2,500 万美元，博思达按持股比例 51%担保不超过 1,275 万美元。

子公司向中国信托银行申请综合授信额度中，芯星电子的综合授信额度不超过 1,200 万美元，由博思达全额担保；香港仁天半导体的综合授信额度不超过 1,000 万美元，博思达按持股比例 51%担保不超过 510 万美元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行博思达内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会。

二、被担保人的基本情况

（一）全芯科微电子科技（深圳）有限公司

1、被担保人的基本情况：

公司名称	全芯科微电子科技（深圳）有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5ET1WF66
法定代表人	苏芳
注册资本	1000万人民币
成立日期	2017年10月19日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址	深圳南山打石一路深圳国际创新谷6栋2105室
经营范围	电子产品、通讯产品、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。
与上市公司存在的关联关系	为上市公司的全资子公司

2、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	15,095.54	13,424.96
负债总额	12,496.62	10,662.49
应收账款	9,940.61	7,586.59
净资产	2,598.92	2,762.47
项目	2025 年年度 (经审计)	2026 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	25,015.20	6,176.15
营业利润	447.80	192.43
净利润	444.41	163.55

经核查，全芯科微电子科技（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

（二）芯星电子（香港）有限公司

1、被担保人的基本情况

被担保人英文名称	SC Electronics (HK) Limited
被担保人中文名称	芯星电子（香港）有限公司
注册日期	2019年3月27日
注册号码	2808495
注册地址	香港金钟金钟道89号力保中心1座10楼1003室
主营业务	电子贸易及电子产品的设计及咨询，技术外包
与上市公司存在的关联关系	为上市公司的全资子公司

2、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	4,444.85	45,677.99
负债总额	3,844.48	43,828.71
应收账款	4,418.90	35,903.72
净资产	600.37	1,849.28
项目	2025 年年度 (经审计)	2026 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	14,928.66	41,426.38
营业利润	611.29	1,513.41
净利润	525.67	1,263.69

(三) 香港仁天半导体科技有限公司

1、被担保人的基本情况

被担保人英文名称	HONGKONG KINGSKY SEMICONDUCTOR CO., LIMITED
被担保人中文名称	香港仁天半导体科技有限公司
注册日期	2025年10月17日
注册号码	78966886
注册地址	香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦12楼A室
主营业务	电子贸易及电子产品的设计及咨询，技术外包
与上市公司存在的关联关系	为上市公司的控股子公司

2、最近一年一期主要财务指标：

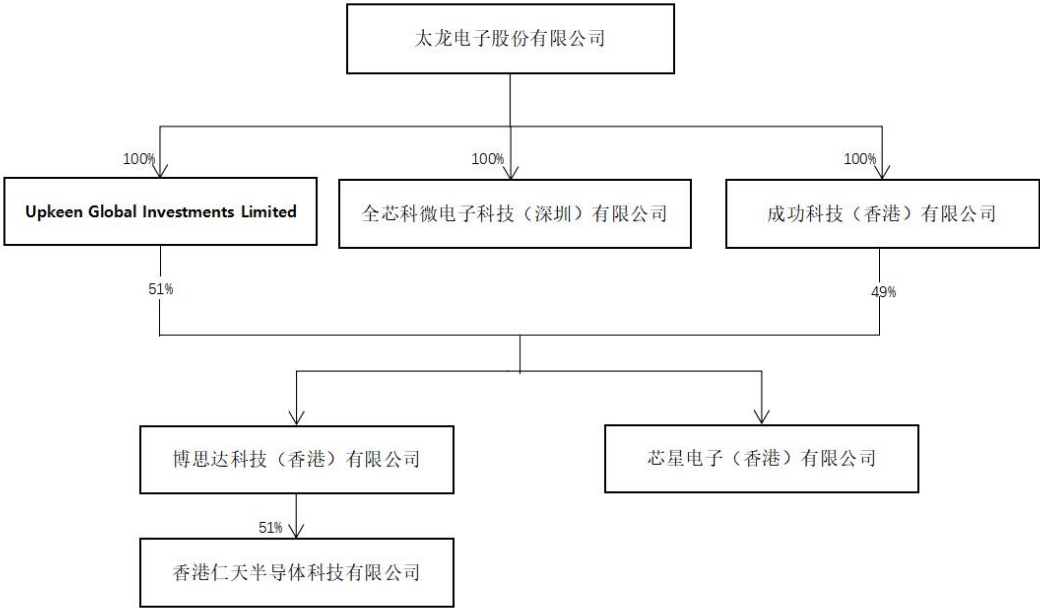
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	-	338,319.56
负债总额	-	0.00
应收账款	-	0.00
净资产	-	338,319.56
项目	2025 年年度	2026 年 1 月-3 月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	0.00
营业利润	-	-14,632.80
净利润	-	-14,632.80

注：香港仁天半导体为新设公司，2025 年度尚未经营，因此无相关数据。

（四）担保人与上述被担保人股权结构如图所示：



三、合同的主要内容

（一）博思达与国泰世华银行深圳分行签署合同的主要内容

- 1、债权人（贷款人）： 国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行
- 2、保证人（押记人）： 博思达科技（香港）有限公司
- 3、债务人： 全芯科微电子科技（深圳）有限公司
- 4、担保方式： 存款质押担保
- 5、被担保最高债权额： 人民币 2,200 万元
- 6、保证范围： 在法律许可的范围内，自行承担费用以采取银行所要求以完善、保护或变现于本押记书项下所授予银行的担保的行为，不论是在任何相关机关或其他人士进行登记或采用任何其他方式。
- 7、担保期间指于押记书日期开始至下列日期结束的期间：
 - （1）所有担保债务被无条件及不可撤销地支付及全额清偿；
 - （2）银行在信贷协议项下或依据信贷协议没有进一步的承诺、责任或义务。

8、反担保条款：无。

（二）博思达与国泰世华银行香港分行签署的担保合同主要内容

1、债权人：国泰世华银行有限公司香港分行

2、保证人：博思达科技（香港）有限公司

3、债务人：芯星电子（香港）有限公司、香港仁天半导体科技有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、被担保最高债权额：

（1）芯星电子（香港）有限公司：1,000 万美元；

（2）香港仁天半导体科技有限公司：总金额为 2,500 万美元，博思达担保不超过 1,275 万美元。

6、保证范围：借款人以任何方式（无论实际或或有、单独或共同、作为主债务人或保证人）在任何货币下对银行到期应付、欠付或产生的所有款项、义务及负债（包括本协议项下的欠款）；上述所述金额所产生的利息（无论是在任何索求或判决之前或之后产生）；银行以完全弥偿为基础，为完善其在本协议项下的权利或执行本协议所产生的相关费用和支出。

7、担保期间：协议为持续性协议。即使发生任何影响借款人受本协议约束能力的事件，本协议项下的所有权利、权力和救济措施仍适用于借款人对银行的所有义务。

8、反担保条款：无。

9、其他相关事项：香港仁天半导体的其他法人股东的实际控制人与国泰世华银行香港分行签订了保证合同，对主合同项下债权提供连带责任保证担保。

（三）博思达与中国信托银行签署的合同主要内容

1、债权人：中国信托商业银行股份有限公司香港分行

2、保证人：博思达科技（香港）有限公司

3、债务人：芯星电子（香港）有限公司、香港仁天半导体科技有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、被担保最高债权额：

（1）芯星电子（香港）有限公司：1,200 万美元；

(2) 香港仁天半导体科技有限公司：总金额为 1,000 万美元，博思达担保不超过 510 万美元。

6、保证范围：担保人须偿还借款人根据所有相关贷款文件、担保文件及任何其他文件在任何时间就银行授信或与之有关而到期、欠付、应偿还或所产生之任何货币类别的所有金额及责任，无论系现在或未来、实际的还是或有的、主要的或附带的、受担保或未受担保、从属或非从属、以任何身份（包括借款人因违反合约而须支付赔偿之任何义务）；依据借款人所适用之利率，期间所产生之所有利息（包括任何要求或判决之前或之后），及中国信托银行以完全弥偿基准为执行本保证书之所有费用、成本、支出及垫付费用（包括但不限于法律费用、任何汇兑管制之溢价及罚款）。

7、保证期间：本保证书系持续之保证，于任何受保证之义务仍未完全清偿期间保证全部受保证之义务，并维持完整效力、有效性及效力直至本行收到保证人或保证人之清盘人或接管人的书面终止保证通知满一个历月后为止。

8、其他相关事项：香港仁天半导体的其他法人股东的实际控制人与中国信托银行签订了保证合同，对主合同项下债权提供连带责任保证担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 8 月 12 日，公司实际担保余额为人民币 35,089.28 万元或等值外币（含本次担保），占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 27.81%。

除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

五、备查文件

- 1、《押记契据（三方立约押记契据）》；
 - 2、《保证书》；
 - 3、《一般融资授信》；
 - 4、博思达科技（香港）有限公司的董事会、股东会决议。
- 特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日